

低挥发导热硅胶片

TP400-H50-L是一款低挥发导热垫片，使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成，双面自粘，低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能，在-40℃~200℃可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。

特性和优点

- 导热系数3.5W/(m·K)
- 低压缩力应用
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 低挥发
- 容易装配可重复使用

典型应用

- LCD背光模块
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 平面显示器

| 典型属性 | | |
|--|------------------|-----------------|
| 属性 | 典型值 | 测试方法 |
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 厚度 (mm) | 0.5~6.5 | ASTM D374 |
| 密度 (g/cc) | 3.15 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 50 | ASTM D2240 |
| 重量损失 (% @150℃) | <0.2 | ASTM E595-07 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D10 (ppm) | ≤50 | / |
| 挥发冷凝物含量 | 无挥发冷凝物 | 玻璃瓶烘烤180℃/8h,目测 |
| 耐温范围 (℃) | -40~200 | / |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 保质期 (月) | 12 | 温度<40℃避免挤压、暴晒 |
| 电性能 | | |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥6.0 | ASTM D149 |
| 介电常数 (@10MHz) | 7.3 | ASTM D150 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 10 ¹³ | ASTM D257 |
| 导热性能 | | |
| 导热系数 (W/(m·K)) | 3.5 | ISO 22007-2 |
| 热阻 (℃·in ² /W @20psi,1.0mm) | 0.25 | ASTM D5470 |